

2020 年 1 月 15 日

代理店 各位

ハギワラソリューションズ株式会社

SATA 3.0Gbps CFast 製品 4M 変更(基板ロケーションマーク追加)のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、表題の製品において、トレーサビリティ改善の一環として、基板個片内に配置されている位置決めマーク部分に半田を載せることで、位置決めマークを基板シート内のロケーションマークとして使用するよう、運用変更させていただきます。

なお、製品型番および仕様書記載事項、ならびに製品の性能・機能・環境資料に変更及び影響はございません。

詳細について、下記のとおりご案内させていただきますので、ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 対象製品型番

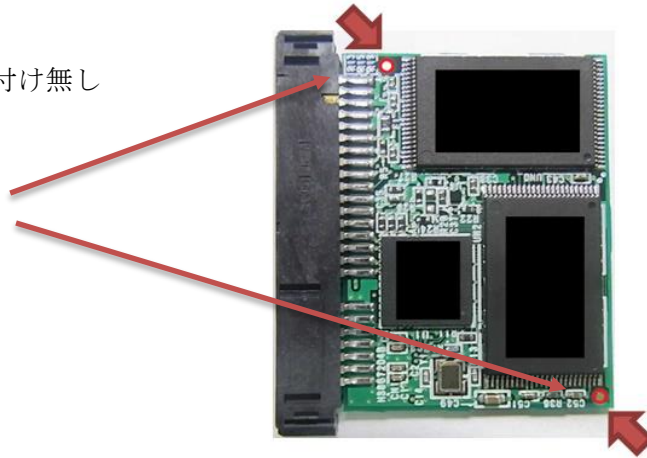
種別	シリーズ名	搭載 NAND		製品型番
		種類	世代	
SATA 3G CFast	LFD10S シリーズ	MLC	15nm	LFD10S-xxxGC(AxxAHx
	XFD10S シリーズ	Q-MLC	15nm	XFD10S-xxxGC(AxxAHx
	HFD10S シリーズ	SLC	32nm	HFD10S-xxxGB(AxxADx HFD10S-xxxGC(AxxADx
			24nm	HFD10S-xxxGB(AxxAEx HFD10S-xxxGC(AxxAEx

*カスタム品も含む

2. 変更内容

【現状】

位置決めマーク部には半田付け無し



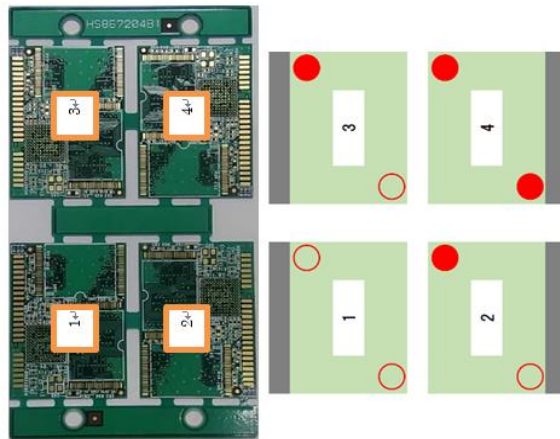
【変更後】

位置づけマーク部の一部に半田の載せ、基板シートロケーションマークとします



基板個片内に配置されている2箇所の位置決めマークの一部に半田を載せることで、基板シート内のロケーションマークとして使用します。

(図：赤丸●部分のみ半田を載せる)



※ 基板配線に影響ない部分での半田付けの為、信号特性、および他の部品への影響はございません。 よって製品スペック・製品信頼性について変更はございません。

比較	現行品	ロケーションマーク追加品
搭載部品	変更無し	
消費電流	変更無し	
転送速度	変更無し	
ファームウェア	変更無し	
含有成分・質量	変更無し(*)	
その他仕様	変更無し	

*基板上に載る半田は実装に使用する半田であり、使用量も誤差レベルの微量のため変更無しとしております。

3. スケジュールについて

2020 年 4 月以降の出荷分より、変更品へ順次切り替えの予定となります。

但し、設備稼働状況により早まる可能性がございます

※備考：製品仕様書・信頼性試験レポート・環境資料の変更はございません。

4. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当までご連絡ください。

弊社では今後とも、より良い品質の向上に努める所存ですので、弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上